解説

X線縮小投影露光技術

博雄 木下

NTT **LSI**研究所

X-ray Projection Lithography Using Multilayer Mirrors

Hiroo Kinoshita

NTT LSI Laboratories

A feasibility study on soft x-ray reduction lithography using multilayer mirrors has been performed. An exposure wavelength range of 70 to 110 Å is proposed as most suitable with current technology. With the aim of providing multilayers with very sharp interfaces and high reflectivity, we attempted to improve the multilayer fabrication process, with one results being the fabrication of an amorphous Mo/Si multilayer, by controlling substrate temperature. A new telecentric optics consisting of two-aspherical mirrors has been proposed. The experimentals were performed on the SR beam line BL-1 of the KEK-PF storage ring. Demagnifying exposure patterns of less than 0.15 um have been obained using multilayer reflecting mask.

1. まえがき

X線縮小投影露光の研究1-6)は近年急速に進展 してきており、最近では0.1 µm技術として位置づ けられてきている。その背景には高い反射率をも つ多層膜製造技術の進歩がある。130Åの波長での Mo/Si多層膜の場合には 50%以上の反射率が直入 射でも容易に得られるようになり、複数のミラー からなる光学系でも十分実用になるものが作られ るようになってきている。

筆者らは多層膜を形成した反射縮小光学系によ る軟X線領域での縮小露光方式を提案してきた。

この方式による特長としては,

- 1) 軟 X線による縮小露光のため、 0.05 μm程の微 細パタン形成も可能。
- 2) 反射形マスクが使え, 歪の無い高精度なパタン 形成が可能。また,反射形のため冷却機構が付 加でき、熱歪を避けることが可能。
- 3) 多層膜を用いるため、波長領域が50Å以上とな るが、この領域では2次電子の飛程が十分小さ く, 高精度なパタン形成が可能, また, レジス ト感度が向上する。

などがあげられる。

ここでは、 X線縮小投影露光の研究の現状と今 後の課題について述べる。

-17 -

2. X線縮小投影露光システムと露光波長⁶⁾

表1にX線縮小投影露光システムの目標性能と 各構成要素の開発目標を示す。縮小光学系として リング開口をもつ系を想定している。

レンズ性能としての開口数NAは,波長と解像 度とから決められ,波長を130Åとし,解像度dを 0.1 µmとすると0.07以上を必要とする。要求され るレジスト感度は縮小光学系の効率によって,す なわち何枚のミラーで縮小光学系を構成するかに よっても異なる。表1の値は2枚光学系での要求値 である。これらの各要素,縮小光学系,多層膜反 射率,レジスト等は波長依存性をもち,システム 設計においては波長をどこに選ぶかが重要であ る。以下に波長選択の要因として,波長と光学系 の開口数で決まる解像度と焦点深度,多層膜の反 射率,レジスト厚と感度について述べる。

図1は光学系を無収差としたときの解像度と焦 点深度の波長依存性を示したものである。光学系 を無収差とし、光源がインコヒーレント光とした ときの解像度dはフランホッファの式(1)を基に、 焦点深度dfはレーリの式(2)によって規定され る。

	$d = \lambda / $	(2NA)	(1	ň)
--	------------------	-------	----	---	---

 $df = \lambda / (2NA^2)$ (2)

ここで、λは波長、NAは開口数である。

目標とする解像度を $0.1 \mu m$, 焦点深度を $\pm 1.0 \mu m$ とすると図の2本の線で囲まれた領域が波長とNA のとりうる値を示す。

長波長側の限界は200Åであり、必要となる NA は 0.1である。短波長化するほど NA は小さくてよ く、反射光学系の設計の容易さが増大する。焦点 深度を± 0.5 μ mとすると400Åの真空紫外光を利 用でき、この波長光を用いた0.1 μ m加工を Bell 研 究所が提案している。このときの光学系の NA は 0.2以上必要となり、少ないミラー枚数での露光光 学系を構成することが困難となり、短波長化のメ リットが生かされない。

このため、縮小光学系としての種々の条件を満 足させる反射光学系のNAを0.1とすると200Å以 下の波長域がX線縮小投影露光での露光波長と考 えられる。

図2に上記の波長領域で高い反射率が期待でき る多層膜の波長依存性を示す。ここで、多層膜の 製作可能な一層の膜厚を10Å程とすると、40Å程

仕様目標 解像度 焦点深度 スループロット	≦ 0.1 µm ≥± 0.5 µm ≧ 25枚∕hr (6in)
縮小光学系 NA ≥ 0.07 露光領域 ≥ 20mm 縮小率 ≒ 1/5	反射形マスク 最小パターン ≤0.5 μm コントラスト ≥7(強度比)
多層膜製作 反射率 ≥ 40% バンド幅 ≥ 5Å	レジスト 感度 ≤ 10mJ/cm ² 膜厚 ≥ 0.3 μm 解像度 ≤ 0.1 μm
基板加工 非球面 形状精度 ≤ 20 Å 面粗さ ≤ 5 Å	走査位置合わせ機構 真空中 真直度 0.01 μm/20mm 同期走査

Table 1	Poquiromonto	for Y-roy	projection	lithography
l aple l	Requirements	Ior A-rey	projection	innography



Fig.1 The optical characteristics dependence on x - ray wavelength.



Fig.2 The reflectivity efficency of Ni/C, Ru/B₄C and Mo/Si multilayer.

が露光波長の下限となる。

40~200Åの波長領域で高反射率が得られる軽 元素の物質としてはこの波長領域に吸収端をもつ C, B, Be, Siが挙げられる。Cの吸収端を越え た領域では光学定数だけから判断すればNi/Cが よく,反射率として20~30%以上得られるが, 半値幅が0.5Å以下と狭くなる。光学系を構成する 多層膜ミラーのマッチングを考慮すると1枚ミ ラーの反射率の半値幅としては5Å以上必要であ る。

Bは自然界では化合物として存在し, BCを例 として考えると, Ru/BCでは70Aの波長で50% の反射率と5Å程の半値幅が得られる。

Beは114Åに吸収端をもつが取扱が難しいこと からほとんど作成例がない。

Siは Mo, Ru, Rhとの組合せで 70%を越える 高い反射率が得られ、半値幅として 5Å以上が得ら れる。実際にも 70%近い反射率の報告もある。

このように、反射率はCを越えた波長域でも数 10%の反射率が得られるが、多層膜の反射強度の 半値幅は短波長化につれて狭くなる。ピーク反射 率と半値幅の積の大きい事が望まれる露光用の多 層膜としては半値幅が5Å以上とれる70Å以上の波 長が適している。

図3に PMMA, FBM のポジ型レジスト, ネガ 型の SPP (Si含有レジスト)の露光深さの波長依



Fig.3 Calculated exposure depth of several resist.

存性(計算値)を示す。この値は入射光のエネル ギーが1/eに減衰したときの値でのレジストへの 光吸収深さを示す。130Å程では吸収のため2000Å 程しか光電子が内部に入らない。レジスト厚はパ タン幅の3~5倍必要とすると言われており、0.1 µmパタンに対しては0.3µm以上の厚さが必要とな る。上記のPMMA レジストの場合には波長を 110Å以下とせねばならない。130Å以上の波長域 では露光深さが0.2µm以下となり、多層構造レジ ストを用いざるを得ない。

以上のように、X線縮小投影露光の露光波長は レジストに多くの進展がないものとするならば70 -110Å程の波長とするのが適当であるが、多層膜 の高反射率化を実現せねばならない。露光波長を 130Åとするならば、多層構造レジストとせねばな らない。もしくは図のSi含有レジスト(SPP)の例 のように、この領域で吸収端をもつ物質を添加し たレジストの開発、またシリル化等を利用した表 層露光に適した新しいレジストプロセスの開発が 必要となる。

3. 縮小光学系の設計

ミラー光学系による縮小光学系は色収差が無い ために領域を限れば2枚光学系で0.1 μm以下の解 像度を得ることも可能であるが、リソグラフィ技 術としては1チップ分に相当する露光領域と高い スループットとが要求される。1GDRAMの時代 には1チップの短辺が20mm以上とも言われてお り、大面積をいかに実現するかがミラー光学系の 課題である。光学系の縮小率はチップサイズと作 成可能なマスクサイズ、広げられる光源の大きさ から考えても1/5以下が適当である。

大面積化は、収差の小さな同心円状(リング開 口)の領域をマスクとウェハの同期走査によって 拡大する方向と一括大面積を可能とする光学系を 実現しようとする方向とがある。一般に前者は少 ないミラー枚数で実現でき、後者は収差補正のた め多くのミラー枚数を必要とし、スループットの 低下を余儀なくされる。

これらは使用する光源の性質,放射光もしくは レーザプラズマのような光源を用いるかによって も異なり,放射光の場合には縦の開き角を一様に 広げることは容易ならぬことから,前者の同心円 状の開口を走査する方式が有利となる。

図4に NTT が提案⁷⁾ したリング開口方式の2枚 ミラー縮小光学系を示す。この光学系は、ウェハ 面に対してテレセントリック性を有しており, 焦 点深度,位置合わせ等に有利な構成となってい る。波長130Åで0.1 μmの解像度を確保するよう に NA0.07 で設計した。 縮小率は 1/5 である。 図5 に光学特性として MTF(sin 波) を示す。5000本/ mmで MTF40%以上の回折限界に近い性能を得てお り、焦点深度が1µm変動しても MTF 値の変化は ほとんどない。また、図6にリングフィールド内 での歪を示す。12.5mm半径のリングフィールド内 で, 歪 0.01 µm以下とする横幅は 0.4mmまでとれ る。走査することにより得られる露光領域として は20mm角以上が可能である。この光学系は2枚と も非球面光学系を必要とするが、最小ミラー枚数 で要求条件を実現させた案である。

図7にAT&TBell研究所が提案^{®)}している大面積 一括の1/5縮小系の例を示す。露光領域10× 15mmで,ディストーションを1µm以下とするため



Fig.5 MTF curves of designed optics for incoherent illumination. NA is 0.07, wavelength is 130 Å.



Fig.7 Designed optics with large exposure field (AT&T).

$$-20 -$$

に4枚とも非球面化している。NAは0.08であ り, MTFは5000本/mmで40%(矩形波)程であ り,解像度0.1 µmを露光可能とする光学系案を得 ている。このような光学系では,MTFとディス トーションとがトレードオフの関係にあり,両方 を満足させるにはさらに多くの反射枚数を必要と する。

上記の2つの例で1枚のミラーの反射率を50% とするとスループットとしては4枚系の後者は1/ 4に低下し,高スループット化にはいかに少ないミ ラー枚数で実現するかが要点である。また,1枚 のミラーの形状精度への要求値もミラー枚数をn とするとλ/8nとなりミラー枚数の増加につれて 加工精度も厳しくなる。

以上のように、20mm以上の露光領域で0.1 µmを 解像する光学設計案は各種得られており、今後は いかに高精度な非球面光学系を大口径で実現する かが課題である。

4. 多層膜の製作

露光システムの高スループット化では多層膜ミ ラーの反射率の向上が最も重要となる。X線によ る近接露光システムとのスループット比較の点か ら1枚ミラーの多層膜の反射率としては40%以 上,半値幅としては5Å以上が望まれる。また,多 層膜の反射率は重元素と軽元素の物質の組合せと 波長で決められるが,実際には,多層膜製作法に 多くを依存しており,2つの層の界面が急峻で, かつそれぞれの層が均質(アモルファス)に形成 されることが重要である。

多層膜の製膜技術としてはマグネトロンスパッ タ,イオンビームスパッタ,電子ビーム蒸着法が 検討されている。イオンビームスパッタ法は膜形 成時の真空度も低く,良質なアモルファスな膜が 形成できているが,膜形成速度が遅いため,多層 化するほど装置の不安定性に起因するとおもわれ る膜厚変動が生じ,十分な反射率が得られていな い。電子ビーム蒸着法はスパッタ源の形状変化, 水晶振動子による膜厚制御性に問題がある。この ため,現状の膜形成法ではマグネトロンスパッタ による膜形成が最も高反射率化に適している。

図8にNTTの境界領域研が開発したマグネトロ ンスパッタによる多層膜形成装置⁹⁾を示す。6イ ンチのターゲット3個を有し,試料ホルダーには4 インチウェハを6枚まで装着可能である。この装 置は高精度な膜厚制御のために試料ホルダーの回



Fig.8 Schematic illustration of magnetron sputter deposition system.





(b)

Fig.9 Cross-section TEM photograph of Mo/Si multilayer fabricated at a differrent substrate temperature (a) high temperature (b) low temperature.

転精度を向上させ,回転数とシャッターの開閉時 間とから膜厚を制御している。各層の厚さのバラ ッキは平均1原子以下である。また,特殊な形状 のシールドマスクをターゲットー試料間に設ける ことにより半径方向の膜厚補正を行い,4インチ ウェハ全面での膜厚変化1%以下を実現している。

成膜上の問題としては界面の粗さの低減化が検 討されている。図9はマグネトロンスパッタで作 成した Mo/Si 多層膜の TEM 像^{iの} である。



Fig.10 Measured reflectivity of a Mo/Si multilayer mirror.

(a)は通常の条件(基板加熱)での作成例であり, Mo層が多結晶化しているのが観察される。結晶の 大きさは100Å程もあり,これが界面の粗さを増大 させている。このため Mo層のアモルファス化を 試みた。(b)は基板を冷却して膜形成した例であ り, Mo層をアモルファス化することができ,界 面あらさを低減させることができた。この他 Mo層のアモルファス化としてMoの合金化¹¹⁾, Si の化合物化の検討がなされている。

多層膜の反射率評価には,使用する波長,入射 角での評価を必要とするため放射光を用いてい る。

図10に放射光を用いた反射率測定例を示す。反 射率測定は高工研BL-1Bに平面回折格子型分光器 を置き、θ-2θをもつ反射率計で測定した。波長 130Å,入射角15度でのMo/Si多層膜の反射率と して51%,半値幅も6Å近く得られている。この 多層膜を用いれば上記の2枚反射形縮小光学系と 反射型マスクを含めた3枚ミラー構成でも12%以 上の反射効率が得られ、以下で述べる長波長での レジスト感度の向上とを合わせて高スループット の見積りも可能となる。



Fig.11 Measured sensitivity of PMMA resist.



Fig.12 Estimation of throughput.

以上のように、マグネトロンスパック技術によって Si の吸収幅より長い 125Å 以上の波長域では 50%以上の実用反射率が得られている。今後はよ り短波長域(70Å程)での高反射率化が課題であ る。このためにはさらなる界面の粗さの低減化の 検討が必要である。

5. 長波長域でのレジスト感度測定¹¹とス ループット試算

図 11 に放射光を用いた PMMA レジストの 70-130Åでの感度測定結果を示す。測定には分光光を 用い, 70-130Åでのドーズ量と露光深さを求め



Fig.13 Schematic illustration of the experimental setup to evaluate the image forming characteristics.

た。感度は長波長化するにつれて向上し, 130Åの 波長で 2000Åの膜厚を露光するのに必要なエネル ギーは 100mJ/cm²程である。これは波長 10Åの露 光感度に比べて 10倍ほど向上している。

図12に2枚ミラー光学系でのスループット試算 を示す。放射光の強度は高エネルギー物理学研究 所放射光施設BL-1とした。全反射ミラーの反射 率を85%,70,100,130Åでの多層膜の反射率 をそれぞれ30,40,50%とした。この結果波長 に関係なく、上記の100mJ/cm²では6インチウェハ 5枚程得られることがわかる。25枚/時を満足させ るためには10mJ/cm²とすればよく,現存させるレ ジスト,例えばSAL 601 (Shipley 製)では3mJ/ cm²以下の感度が得られており¹³¹,高スループット 化も期待できる。

6. 縮小露光実験5.0

6.1 実験装置の概要

以上の検討をもとに,多層膜を用いた光学系に よるパタン転写特性の評価を進めた。

図13はシュバルツシュルツ光学系に多層膜を形成して構成した縮小投影露光実験装置である。光源には、高エネルギー物理学研究所のフォトンファクトリBL-1を用いた。3度曲げのトロイダルミラーによって短波長をカットし、0.1 µmのカーボンあるいはボロンのフィルターを用いて長波長カットをし、縮小光学系へ適当な波長幅をもつSOR 光を入射する。縮小光学系の前段には円弧状の切り欠きをもつ遮光板を置き光軸に対して同心

円となす光のみをウェハ上に集光させる。マスク とウェハを同期移動させ,かつ,ウェハをマスク に対して縮小倍率分低速で移動させることによ り,広い領域のマスクパタン像をウェハ上に形成 させることができる。

図14に反射型マスクの製造プロセスの1例を示 す。はじめに多層膜を平面度,粗さ精度の高いSi 基板上に形成し,次にレジストをコートし,電子 ビームあるいはフォトリソグラフィによって露光 し,現象する。最後に多層膜をエッチングする。 この方法により多層膜の反射率を損なうことなく パタン形成が可能であり,また,吸収部の基板は プラズマにさらされるため表面荒れを生じ, コン トラストの向上化にもなる。また, 反射面をパタ ン面としているため入射角依存性もなく高精度な パタン形成が可能である。図15に反射形マスクの 形成例を示す。4インチ全面で一様なマスクが形 成できている。

光学系のミラー合わせには X線ズーミング管(浜 松ホトニクス製)を用いた。図16に評価系の構成 を示す。光学系による結像位置に CsI の光電面を 置き電子光学系により 200倍に拡大した像を MCP を通し、CCD カメラで撮影する。光学系は 3軸ス テージ上にあり、像をみながら X線領域での合わ



Fig.14 Procedure of a reflection mask fabrication.



Fig.15 Photograph of a reflection mask.



Fig.16 Schematic illustration of evaluation system for optics.



Fig.17 Characteristics of demagnifying optics.

せが可能である。図17は分光光を多層膜光学系に 入射したときの映像出力を示している。130Åを ピーク波長として作成した多層膜の反射率の波長 特性とよく一致していることから,2枚の多層膜 ミラーのマッチング度も測定できることがわか る。現状での解像度は0.5μm程であり,光学系の 解像度評価には不十分であるが,X線による光学 系の合わせには十分な性能を確認できた。

6.2 実験結果5.6)

図18に反射形マスクを用いた露光結果を示す。 多層膜には Mo/Si を用いており,露光波長は 130Åとした。露光領域は,0.8×0.15mmである。 レジストは高アスペクト比のパタンを得るため に、3層構造とし、構成は PMMA (800Å)/a-Si (200Å)/OFPR (4000Å) である。PMMAを露光現 象後、中間層の a-Siを SF₆、下層レジストをO₂の 反応性イオンエッチングで加工した。

(a)では1/8に縮小された0.2 μmのラインアン ドスペースパタンが形成できている。(b)は,孤立 パタンの形成例である。0.15 μmのパタンが形成で きている。

7. あとがき

以上述べてきたように,多層膜を用いたX線縮 小投影露光によって微小領域(1mm以下)では0.1 µm



(a)



(b)

Fig.18 Example of replicated pattern. (a) 0.2 μ m lines and spaces pattern (b) 0.15 μ m isolated pattern.

程のパタン形成も実現できており,微細加工性能 を実証できた。しかしながら,リソグラフィ技術 としてみたときにはその実現化のためのスタート ラインにようやっと立った状況にあり,今後は非 球面光学系の製作によって大面積露光の可能性を 早急に明らかにせねばならない。

文献

1) 木下博雄, 金子隆司, 武井弘次, 竹内信行, 石原

直,X線縮小投影露光の検討,第47回応用物理学 会学術講演会予稿集 p.322(1986).

- A.M. Hawryluk and L.G. Seppala, J. Vac. Sci. Technol. B6, 2162(1988).
- H. Kinoshita, K. Kurihara, Y. Ishii and Y. Torii, Soft X-ray reduction lithography using multilayer mirrors, J. Vac. Sci. B7, 6(1989)1648.
- 4) D.W. Berreman, J.E. Bjorkholm, M. Becker, L. Eichner, R.R. Freeman, T.E. Jewell, W.M. Mansfield, A.A. MacDowell, M.L. O'Malley, E.L. Raab, W.T. Silfvast, L.H. Szeto, D.M. Tennant, W.K. Waskiewicz, D.L. White, D.L. Wendt and O.R. Wood, Appl. Phys. Lett. 56(22), 28 May(1990).
- H. Kinoshita, K. Kurihara, T. Mizota, T. Haga, Y. Torii, H. Takenaka, Y. Ishii, Soft X-ray reduction lithography using a reflection mask OSA Proceedings on Soft-X-Ray Projection Lithography, 12, 11(1991).
- H. Kinoshita, K. Kurihara, H. Takenaka; Soft X-ray reduction lithography using multilayer mirrors J. J. A. P 1991. Nov.

- K. Kurihara, H. Kinoshita, N. Takeuchi, T. Mizota, T. Haga and Y. Torii, J. Vac. Sci, Technol B9, (1991).
- T.E. Jewell, J.M. Rodgers and K.P. Thompson: Reflective systems design study for soft-X-ray projection lithography, J.Vas. Sci. Technol. B8, (1990)1519.
- Y. Ishii, H. Takenaka and H. Takaoda; MRS Int'l. Mth. on Adv. Mats. 10, 321(1989).
- H. Takenaka, Y. Ishiii, H. Kinoshita, K. Kurihara, Soft and Hard X-ray Reflectives of Multi-layers Fabricated By Alternating-material Sputter Deposition, Proc. SPIE, 1345 213 (1990).
- 11) 芳賀恒之他;第52回秋季応物 9a-ZB-4(1991).
- 12) 溝田 勉,芳賀恒之,栗原健二,木下博雄,長波長 領域におけるレジスト感度特性,第52回応用物理 学会学術講演会予稿集 9AZG-11.
- 13) G.D. Kubiak, E.M. Kneedler, K.W. Berger, R.H. Stulen, J.E. Bjorkholm, W.M. Mamsfield and N. Windischmann; Rresist Characterization at Soft-X-Ray Wavelengths, OSA Proceedings on Soft-X-Ray Projection Lithography, 12, 124(1991).

さいわーど

X線縮小投影露光

軟×線領域での縮小露光技術。縮小光学系にはミ ラー光学系に多層膜を形成したものを用いる。露光波 長は44Åから200Åが用いられており、光源にはシンク ロトロン放射光の他、レーザプラズマ光源が検討され ている。マスクには多層膜を反射面とした反射型が用 いられる。解像度の限界は100Å程である。

多層膜

重元素からなる物質と軽元素からなる物質を交互に 幾層にも形成した膜。軟×線領域で直入射でも数10% の反射率が得られる。波長,入射角,周期長(1組の 厚さ)がブラッグの条件で決められ,分光素子として 作用する。